

スマートプロセス学会誌

目 次 Vol. 12 No. 5 2023 (令和 5 年 9 月)

Mate2023特集号—第29回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム

会 告	N21
卷 頭 言	Mate2023 特集号によせて 山内 啓.....	237
研 究 論 文	液相拡散接合における粒子構造が接合強度に及ぼす影響 高尾露茜・石谷伸治・古澤彰男・大橋直倫・日野裕久.....	238
	局所誘導加熱を利用した非接触はんだづけにおける加熱特性 熊田泉実・坂井雄一・清水孝晃・高柳 毅・石橋大輔.....	246
	四端子法を活用したワイヤボンディング寿命のその場測定手法の開発 荻谷健人・宍戸信之・尾崎仁哉・浮田昌也・中原 健.....	251
	銅系導電性ペーストの電気伝導特性に及ぼすアミノエタノールおよび その誘導体のフィラー表面処理効果の分子構造依存性 松浪由香里・小田島大輔・井上雅博.....	257
	LPD 法による SnO ₂ を用いたガラス基板に対する銅めっき皮膜の密着機構 佃 真優・長尾敏光・片山順一・廣岡あすか 妹尾駿作・速水雅仁・坂田俊彦.....	265
	銅ナノ粒子を用いた転写型接合シートの開発 三好健太郎・高田克則・五十嵐弘.....	271
	クラック三次元解析を用いたリードフレームはんだ接合部の評価 鬼塚梨里・長谷川将司・植木竜佑・小西勝久・高橋政典.....	275
	ギ酸を還元剤としたはんだ付け方法の検討 浅地伸洋・清水悠矢・徳丸 準・中島 泰.....	281
報 告 記 事	エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術シンポジウム (Mate2023) 開催報告 岩田剛治.....	288
一 般 論 文	電磁波シールドパッケージにおけるモールド樹脂とスパッタ成膜間の界面挙動 本間荘一・岡田大地・澤登昭仁 山本 進・井本孝志・西川 宏.....	291
会 報 ・ 掲 示 板	N22

Journal of Smart Processing
Vol. 12 No. 5 2023 (September 2023)

CONTENTS

Special Issue on 29th Symposium on “Microjoining and Assembly Technology in Electronics” (Mate2023)

S.P.S. Announcement N21

Preface

Special Issue on “Mate2023”

Akira YAMAUCHI.....237

Research Papers

Effect of Particle Structure on Bonding Strength in Liquid-Phase Diffusion Bonding
Yumi TAKAO, Shinji ISHITANI, Akio FURUSAWA,
Naomichi OHASHI and Hirohisa HINO.....238

Heating Characteristics of Non-Contact Soldering Technique by
Using Localized Induction Heating
Izumi KUMADA, Yuichi SAKAI, Takaaki SHIMIZU,
Takeshi TAKAYANAGI and Daisuke ISHIBASHI.....246

Development of In-Situ Measurement Method for Wire-Bonding Lifetime Utilizing
the 4-Terminal Method
Kento KARIYA, Nobuyuki SHISHIDO, Jinya OZAKI,
Masaya UKITA and Ken NAKAHARA.....251

Molecular Structure Dependence of Surface Treatment Impact on Electrical Conductivity of
Copper-Filled Conductive Pastes by Amino Ethanol and Its Derivatives
Yukari MATSUNAMI, Daisuke OTAJIMA and Masahiro INOUE.....257

Adhesion Mechanism of Copper Plating Film to Glass Substrate Using SnO₂ by LPD Method
Mayu TSUKUDA, Toshimitsu NAGAO, Jun-ichi KATAYAMA, Asuka HIROOKA,
Shunsaku SENOO, Masahito HAYAMIZU and Toshihiko SAKATA.....265

Development of Transfer Bonding Sheet Using Copper Nanoparticles
Kentaro MIYOSHI, Katsunori TAKADA and Hiroshi IGARASHI.....271

Evaluation of Solder Joints on a Lead Frame Using 3-Dimensional Crack Detection Analysis
Riri ONIZUKA, Masashi HASEGAWA, Ryusuke UEKI,
Katsuhisa KONISHI and Masanori TAKAHASHI.....275

Study of Soldering Process with Formic Acid
Nobuhiro ASAJI, Yuya SHIMIZU, Hitoshi TOKUMARU and Dai NAKAJIMA.....281

Special Report for Mate 2023

Report on 29th Symposium on “Microjoining and Assembly Technology in Electronics”
Yoshiharu IWATA.....288

General Thesis

Interfacial Behavior Between Mold Resin and Sputtered Film Deposited on
Electromagnetic Shield Packages
Soichi HOMMA, Daichi OKADA, Akihito SAWANOBORI,
Susumu YAMAMOTO, Takashi IMOTO and Hiroshi NISHIKAWA.....291

S.P.S. NewsN22